芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟申请新型政策性金融工具事项及全资子公司为公司 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")拟向国家开发银行 全资子公司国开新型政策性金融工具有限公司申请不超过人民币 18 亿元 的新型政策性金融工具
- 公司全资子公司芯联越州为本次新型政策性金融工具提供连带责任保证
- 该事项无需提交公司股东大会审议

一、公司申请新型政策性金融工具及全资子公司为公司担保情况概述

公司及公司控股子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称 "芯联先锋")均为国家高新技术企业,同时芯联先锋承接的"三期12英寸集 成电路数模混合芯片制造项目"制造生产的功率模组应用配套所需各类芯片,是 人工智能、物联网、新能源汽车等众多战略性新兴产业的基础,高度契合数字化、 智能化发展方向,精准匹配科技自立自强、发展壮大战略性新兴产业的政策导向。

基于新型政策性金融工具的落实和推进的契机,为了保障"三期12英寸集 成电路数模混合芯片制造项目"的持续实施,公司拟向国家开发银行全资子公司 国开新型政策性金融工具有限公司申请不超过人民币 18 亿的政策性金融工具, 期限为5年。新型政策性金融工具资金将通过权益性资金注入芯联先锋作为"三 期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目"资本金,并由公司全资子公司芯联 越州集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联越州")为上述新型政策

性金融工具提供连带责任保证。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟申请新型政策性金融工具事项及全资子公司为公司担保的议案》,同意公司向国家开发银行全资子公司国开新型政策性金融工具有限公司申请不超过人民币 18 亿元的新型政策性金融工具,且公司全资子公司芯联越州为公司申请新型政策性金融工具提供连带责任保证。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025年10月17日